

Title (en)

Process for making an inorganic coating on a copper or copper alloy product

Title (de)

Verfahren zur Erzeugung einer anorganischen Deckschicht auf einem Produkt aus Kupfer oder einer Kupferlegierung

Title (fr)

Procédé de production d'un revêtement inorganique sur un produit en cuivre ou en alliage de cuivre

Publication

**EP 1619270 A2 20060125 (DE)**

Application

**EP 05011054 A 20050521**

Priority

DE 102004036082 A 20040724

Abstract (en)

Deposition of a colored inorganic layers on the surface of a product having a copper or copper alloy base material using a metal salt forming reactive chemical, with defatting of the product surface with prior production of a preoxidation layer of oxides of the base material, and wetting of the preoxidation layer by the reactive chemical. An independent claim is included for: a plate- or strip product with the copper or copper alloy base layer as described.

Abstract (de)

Bei dem Verfahren zur Erzeugung einer anorganischen farbigen Deckschicht auf der Oberfläche eines einen Grundwerkstoff aus Kupfer oder einer Kupferlegierung aufweisenden Produkts (Band, Blech, Tafel) unter Verwendung einer Metallsalze ausbildenden reaktiven Chemikalie wird zunächst unter Entfettung der Oberfläche des Grundwerkstoffs des Produkts auf der Oberfläche eine aus Oxiden des Grundwerkstoffs bestehende Voroxidationsschicht erzeugt. Danach wird die Voroxidationsschicht mit der Metallsalze ausbildenden reaktiven Chemikalie filmartig benetzt. Dazu können strukturierte Auftragswalzen eingesetzt werden.

IPC 8 full level

**C23C 22/84** (2006.01); **C23C 8/80** (2006.01); **C23C 28/04** (2006.01); **C25D 11/34** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C23C 8/80** (2013.01 - EP US); **C23C 22/84** (2013.01 - EP US); **C23C 28/04** (2013.01 - EP US); **C25D 11/34** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IS IT LI LT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)

AL BA HR LV MK YU

DOCDB simple family (publication)

**EP 1619270 A2 20060125**; **EP 1619270 A3 20080521**; **EP 1619270 B1 20140430**; CN 1724253 A 20060125; DE 102004036082 A1 20060209; DK 1619270 T3 20140811; ES 2484791 T3 20140812; JP 2006037231 A 20060209; PL 376274 A1 20060206; RU 2005123417 A 20070127; RU 2389825 C2 20100520; US 2006019108 A1 20060126

DOCDB simple family (application)

**EP 05011054 A 20050521**; CN 200510070423 A 20050509; DE 102004036082 A 20040724; DK 05011054 T 20050521; ES 05011054 T 20050521; JP 2005211048 A 20050721; PL 37627405 A 20050721; RU 2005123417 A 20050722; US 18960205 A 20050725